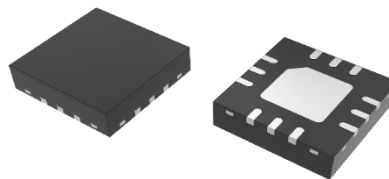


特点:

- 频率范围: 2~6GHz
- 插入损耗: 典型值 0.8dB
- 均衡量: 典型值 6dB
- QFN 塑封
- 尺寸: 3.0×3.0×1.2mm

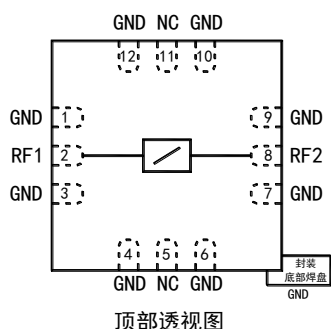
图片:



性能参数: (50Ω 系统)

参数名称	符号	测试条件	参数值				单位	备注
			常温 (+25℃)			全温		
			MIN	TYP	MAX	-55℃~+85℃		
频率范围	f	f=2~6GHz P _{IN} =0dBm	2		6	2~6	GHz	
插入损耗	IL			0.8	1.2	≤1.2	dB	
端口驻波	VSWR			1.2:1	1.5:1	≤1.5:1		
均衡度	EQ		5.5	6	6.5	5.5~6.5	dB	
1dB 压缩点输入功率	IP _{1dB}		+23	+25		≥+23	dBm	

功能框图:



引脚定义:

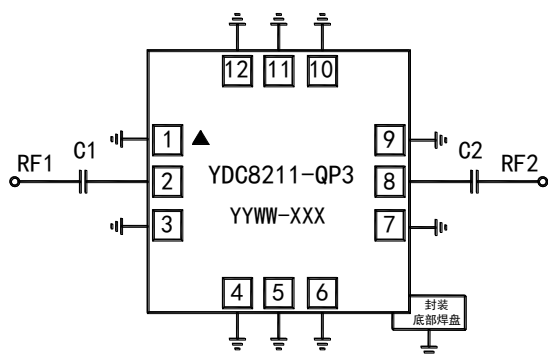
引脚编号	符号	描述
2	RF1	射频端口 1, 内部无隔直
8	RF2	射频端口 2, 内部无隔直
5/11	NC	内部悬空, 建议接地
1/3/4/6/7/9/10/12	GND	接地
底部中央焊盘	GND	接地

极限参数表:

参数名称	极限值
输入射频功率	+30dBm
装配温度	+260℃, 20s
工作温度	-55~+85℃
贮存温度	-65~+150℃
潮湿敏感等级 (MSL)	3
静电放电敏感度等级	1A

超过以上任何一项极限参数, 可能造成器件永久损坏。

推荐应用电路:

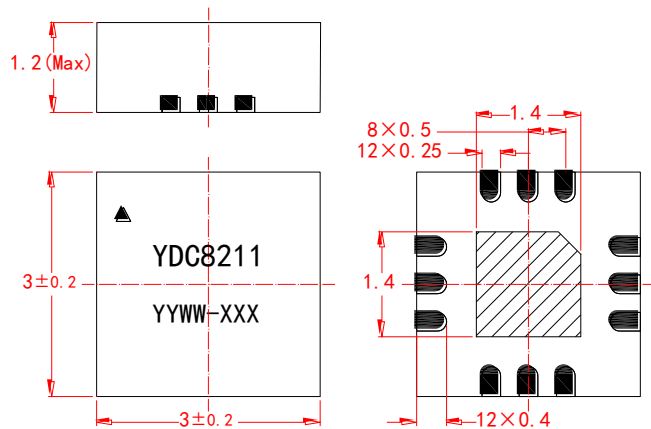


推荐电路值:

位号	型号/数值	备注
C1 C2	33pF	可根据使用频率取值

注: 外部无直流电压时, 可以不加隔直电容。

外形尺寸图:

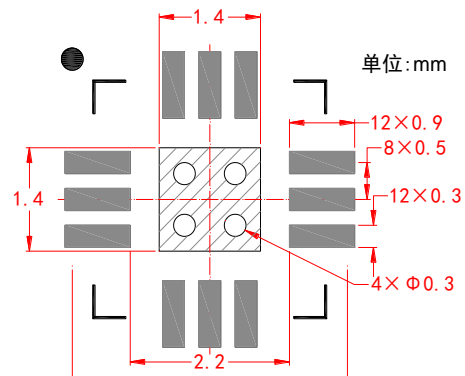


- 注: 1、单位: mm, 未注明公差按 GB/T 1804-m;
 2、产品采用 QFN 塑封封装, 引脚表面镀镍钯金
 (Ni:0.5~2.0um, Pd:0.02~0.15um, Au:0.003~0.015um);
 3、产品标识采用激光刻字。

字符标志:

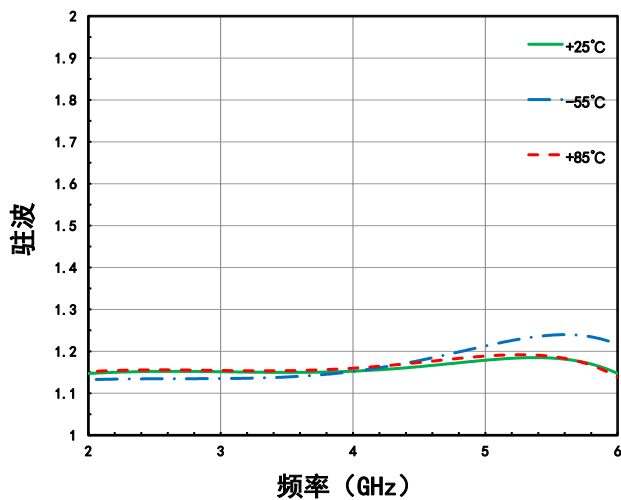
标识	说明	备注
YDC8211	产品型号	不含型号尾缀
▲	1脚&静电敏感标识	
YYWW	批次号	
XXX	序列号	

推荐焊盘图:

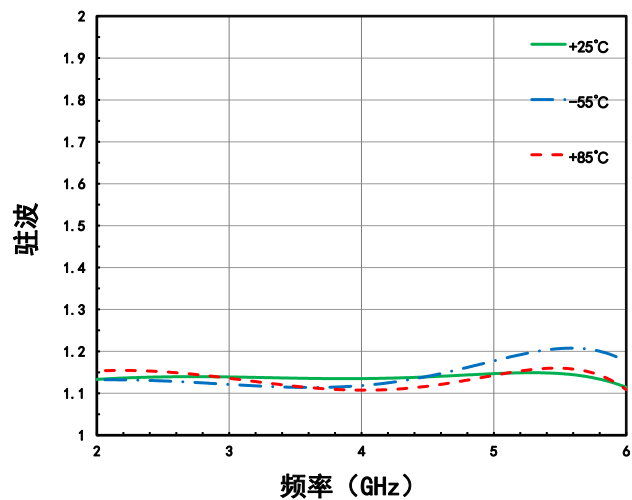


典型测试曲线: (50Ω 系统)

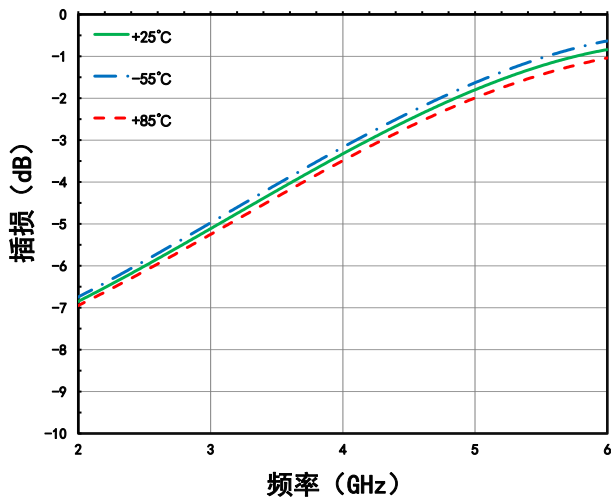
RF1端口驻波VS. 温度



RF2端口驻波VS. 温度

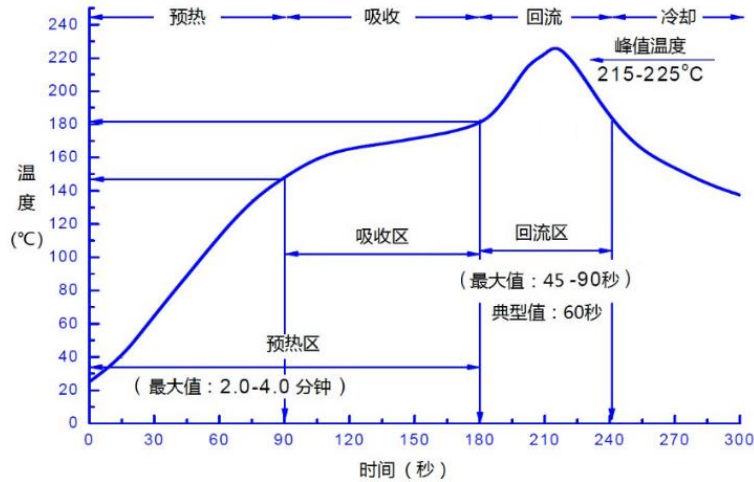


插损VS. 温度



产品使用注意事项：

1. 产品属于静电敏感器件，在运输、装配使用过程中请注意静电防护。
2. 产品属于3级潮湿敏感器件，产品在存储、操作、运输、包装使用过程须按IPC/JEDEC J-STD相关要求执行。
3. 产品使用时请保证接地良好（GND引脚和底部金属化区域）。
4. 产品推荐SMT工艺贴片使用，采用Sn63/Pb37锡膏（熔点+183°C）回流焊接。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流焊设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过极限参数中装配温度。

5. 如特殊情况产品需进行返工返修处理，在返工返修前应按IPC/JEDEC J-STD MSL3级要求对器件进行烘烤处理，避免返工返修过程加热对器件造成热损伤。回流及返工返修次数不大于3次。
6. 如特殊情况需采用手工补焊，烙铁温度+350°C，焊接时间不超过3秒；回流及手工焊接次数不大于3次。
7. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度+10~+35°C，湿度35~65%RH；需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
8. 应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，在焊接及清洗完成后，应对产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。